



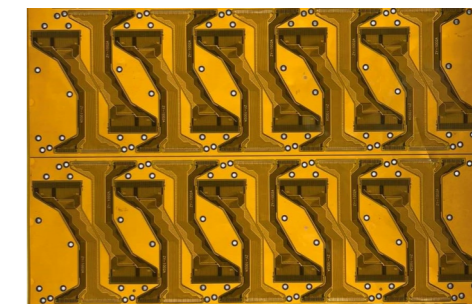
单工位激光切割成型机

Equipment Feature 设备特点

- 软件自动判断Mark点位置, 自动定位图档原点。
- 采用振镜扫描加工方式, 可设置振镜自动校正功能, 有效保证切割精度。
- 采用CCD精确定位, 大视野捕捉范围。
- 专业HMI软件, 标准接口, 支持多产品文件, 支持多语言及时切换, 支持远程控制和数据上传等。

Applications 应用

适用于覆盖膜 (CVL)、柔性板 (FPC)、软硬结合板 (RF) 和薄多层板的切割成形, 以及开窗和开盖等。



外形切割

Parameters 产品参数

项目名称	技术参数	
设备型号	HYM-C650	
PCB、FPC尺寸	650mm x 550mm	
PCB厚度	<2mm	
摄像头	500万像素 CDD相机	
激光类型	紫外皮秒、纳秒, 进口或国产	
激光波长	355nm	
激光功率	纳秒 (15W、20W)	皮秒 (15W、30W)
扫描范围	50mm x 50mm convertible	
激光加工速度	0-3000mm/sec	
最大加工范围	550mm x 650mm	
直线电机	定位精度±0.003mm	
设备外观尺寸	L1711mm x W1450mm x H1715mm (不含三色灯) 不同的平台大小尺寸有变化, 以实际为准。	

